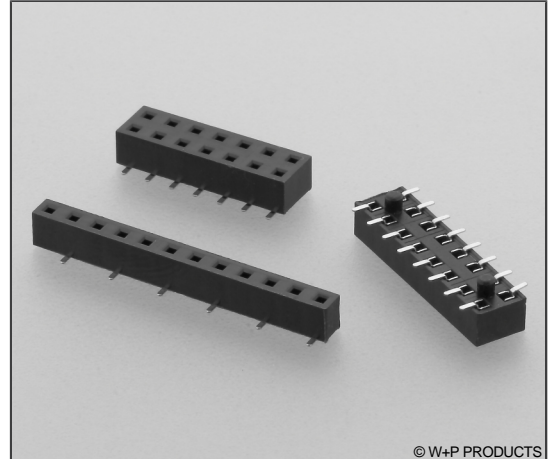


## SMT-Buchsenleisten RM 2,54mm, stehend – BH 3,71mm, beidseitig steckbar SMT Female Headers, 2.54mm Pitch, Vertical – 3.71mm Profile, Dual Entry

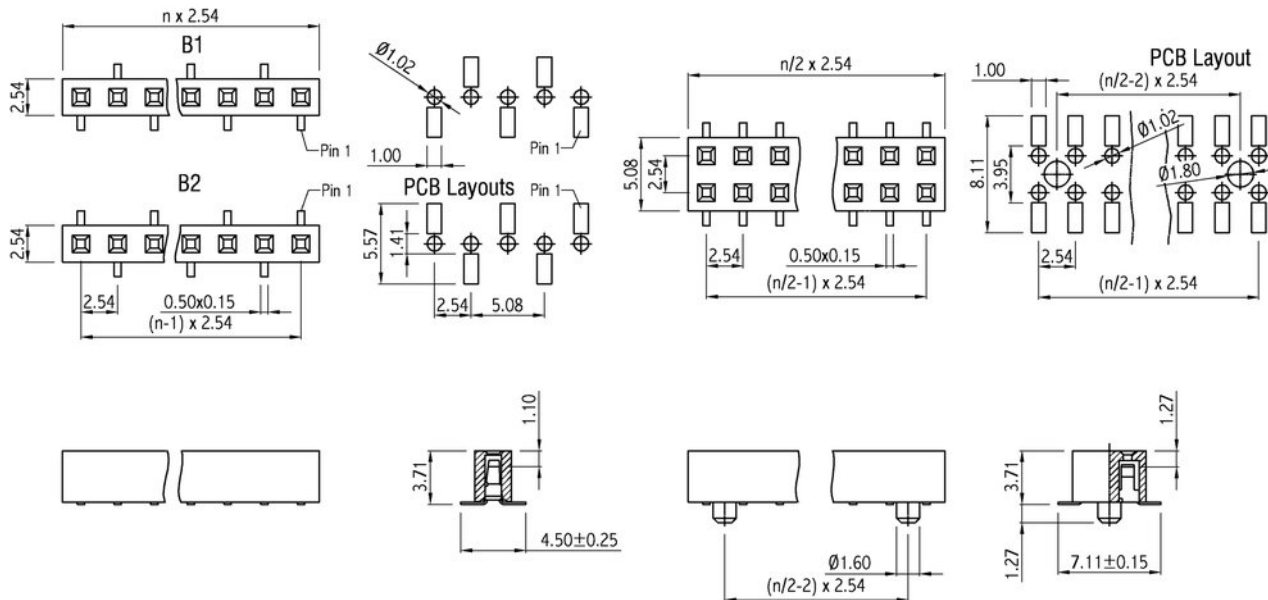
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kontakt für Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	Contact for square pin 0.635mm, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV <sub>DC</sub>
Test Voltage	1kV <sub>DC</sub>
Nennspannung	250V <sub>AC</sub>
Voltage Rating	250V <sub>AC</sub>
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-40°C ... +125°C
Temperature Range	-40°C ... +125°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Doppelfederkontakte für Vierkantstifte 0,635mm.  
Dual beam contacts accept 0.635mm square pins.



Series	Contacts*	Rows*	Plating*	Locating Pegs*	Packaging*
<b>3492</b>	<b>40</b> 04-40 Einreihig Single row 04-80 Zweireihig Double row	<b>3</b> 1 Einreihig B1 Single row B1 2 Einreihig B2 Single row B2 3 Zweireihig Double row	<b>00</b> 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex Plating	<b>00</b> 00 Ohne Pos.hilfen W/o loc. pegs 10 Mit Pos.hilfen (nur zweireihig) With loc. pegs (double row only)	<b>ST</b> ST PPST PPTR

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads

**PPST** In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads

**PPTR** Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

